

爱玛森康明-电子粘合剂

www.emersoncuming.com

ECCOBOND® G500 单组份高强度环氧胶

| | |
|-------|------------|
| 特征: | 优点: |
| 抗塌陷 | 固化时垂直表面不流失 |
| 单组份 | 使用简单 |
| 高温强度高 | 高温结构粘接 |

产品介绍:

Eccobond®G500是一种单组份、热固化的通用型环氧胶粘剂和密封胶。它是一种粘度低，易于泵送，耐摩擦的膏状物质，室温下的保质期较长。Eccobond®G500固化成表面高光的胶层，具有优良的耐热、防水及介电性能。

应用:

Eccobond®G500为铜、其他金属及硬塑料的组装和绝缘而设计，同时也可用于铅与线圈的连接。

材料性能: (固化前)

| 性能 | 测试方法 | 单位 | 数值 |
|-------|------------|-------------------|---------|
| 化学成分 | | | 环氧树脂 |
| 外观 | 目测 | | 灰色膏状 |
| 密度 | ASTM-D-792 | g/cm ³ | 1.45 |
| 压力流 | TP31* | 秒 | 30-60 |
| 抗塌陷性能 | TP29* | mils | 600-900 |

*“TP”为内部试验过程，主要源于ASTM或其他标准。若需要，可以提供这些试验过程的副本。

固化过程:

按表中推荐的固化温度和时间对Eccobond®G500进行固化。为达到最佳固化性能，先进行初始固化，然后在期望最高使用温度下后固化2~4小时。固化时间与固化温度也可改变，如需详细资料请与爱玛森康明的技术代表联系。

150°C时固化质量约8克的胶，没有产生不利的放热反应。

使用指南:

使用前请仔细阅读手册中有关健康与安全须知，注意所有产品标签或个别物料安全数据表(MSDS)中警示。

为保证粘贴组装体的长期性能，必须彻底清洁基片，以除去导致粘结性能差或引起腐蚀的污物如氧化层、灰尘、湿气、盐和油等。关于如何基片的正确处理方法，请参见爱玛森康明的“表面处理：良好粘接第一步”。

鉴于一些添料在运输和存储中会发生沉积现象，建议在使前对容器内浆料进行充分彻底搅拌。

施胶于被粘接表面，并将它们连接在一起，通常只需接触压力。

| 温度(°C) | 固化时间(min) |
|--------|------------|
| 125 | 60 |
| 150 | 20 |
| 175 | 5 |

爱玛森康明-电子粘合剂

www.emersoncuming.com

ECCOBOND® G500 单组份高强度环氧胶

材料性能(固化后):

| 性能 | 测试方法 | 单位 | 数值 |
|--------------------|-------------|----------------|--------------------|
| 硬度 | ASTM-D-2240 | 肖氏D @ 25°C | 86 |
| | | 肖氏D @ 125°C | 70 |
| 拉伸剪切强度 铝对铝@25°C | ASTM-D-1002 | mPa psi | 17.1 2,500 |
| 使用温度范围 | | °C | -40 ~ +180 |
| 介电强度 | ASTM-149 | KV/mm V/mil | 15 380 |
| 体积电阻系数@25°C | ASTM-D-257 | Ohm-cm | 2*10 ¹⁴ |

存储及搬运:

Eccobond®G500的存储有效期在25°C是4个月。存于原装、密封容器。置于凉爽、洁净、干燥的地方。有效期会因应用方法及储存条件有所改变。

睛保护并穿抗化学服饰，以减少直接接触。

以上健康和安全说明只作简单参考，在使用本产品前请仔细阅读MSDS的具体说明。

健康及安全:

Eccobond®G500同大多数工业原料一样，会因接触而刺激皮肤和眼睛，使人体产生不适感觉。在高温条件下，本产品可能产生刺激呼吸系统的气味。在搬运时，应采取良好的工业卫生和安全措施。注意眼

技术规范制定者注意:

以上技术数据只是对本产品主要性能的说明，制定技术规范请咨询爱玛森康明公司办事处，而不必局限于此。

(ECCOBOND®是国民淀粉化学公司的注册商标)

免责声明:

产品的技术数据为特定条件下测试之典型数据，并非其规格说明书，仅供客户使用时参考，敬请客户使用时，以实测数据为准。产品的适用性由客户的认证程序所决定，爱玛森康明不保证典型数据对客户的适用性。

Underfill 底部填充材料

SA 焊膏替代品

SMA 表面贴装胶

General Encap 灌封材料



Adhesive & Conformal Coating
黏合剂及涂覆材料

COB包封材料

TIM 界面导热材料

Film Adhesive 薄膜黏合剂